

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-087

江苏大港股份有限公司 关于子公司 CIS 芯片晶圆级封装产能 扩充的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》，具体内容公告如下：

公司子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟使用自筹资金在原有产线上增加设备的方式扩充8吋CIS芯片晶圆级封装产能，预计总投资13,000万元，产能扩充分两期实施，其中首期新增产能3,000片/月。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项需提交公司股东大会审批。本次扩产事项基本情况如下：

1、扩产目的：本次扩产是为了满足8吋CIS芯片剧增的市场需求，抢抓8吋CIS芯片晶圆级封装发展契机，提升苏州科阳产品市场份额和规模效益，进一步优化公司集成电路产业结构和布局。

2、扩产内容：本次扩产是在原有月产能 12,000 片的基础上，通过增加设备的方式，主要建设 8 吋 CIS 芯片晶圆级封装产能，分两期实施，预计总投资 13,000 万元，其中首期投资 7,000 万元，扩建 8 吋 CIS 芯片晶圆级封装产能 3,000 片/月，扩建完成后 8 吋 CIS 芯片晶圆级封装产能增加至 15,000 片/月。二期投资 6,000 万元，产能扩建主要用于 CIS 芯片和滤波器芯片封装等。

3、扩产建设周期：2020 年一季度，完成首期产能扩充 3,000 片/月，二期将根据市场需求择机实施。

4、资金来源及用途：本次扩产所需资金 13,000 万元全部由苏州科阳自筹，主要用于增加溅射机、显影机、压合机、研磨机、干法蚀刻机、切割机、植球机等核心设备。

5、对公司的影响：苏州科阳是公司集成电路封装业务运作平台，扩充8吋CIS芯片晶圆级封装产能有利于进一步提升苏州科阳产品市场份额、行业地位和竞争优势，有利于进一步优化公司集成电路产业布局，符合公司聚焦发展先进封装和高端测试的集成电路产业发展战略。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日